|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023年度 東京都立産業技術高等専門学校**  **スタートアップ教育支援プログラム「地動計画」**  **第１期　志望理由書** | | | |
| **年** | **コース** | **番** | **氏名：** |

**送付先：kikaku@jmj.tmu.ac.jp**

|  |
| --- |
| 1. **地動計画に参加を希望する理由について、その背景もふまえて記入してください（250字～330字）。**   《入力時参考：MS明朝　16ポイント×28字×12行以内》 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **以下のお題①～③のいずれかを選択し、そのお題に応じた写真をまずは撮影してください。そして、その写真を撮影した理由を含めて、撮影した内容を見て思ったこと、考えたこと等を自由に説明してください（200字～400字）。**   **＜お題＞**  **①日常にあるモノゴト・あたりまえの中で疑ってみたもの【疑】**  **②技術的にすごい・面白い・気になると思ったもの【技】**  **③これで遊んでみたいと思ったもの【戯】**  **※上記は、地動計画のカリキュラムコンセプト「疑技戯」に沿ったお題となっています。**  **- 疑：見つめ直すこと**  **- 技：取り扱うこと**  **- 戯：遊びの中で見つける**  **※写真の貼り付けが難しい場合は、文字(文章)で説明してもOKです。**  《入力時参考：MS明朝　16ポイント×28字×15行以内》 |
| ●撮影写真  ●タイトル  ●撮影内容の説明 （上記の写真を撮影した理由含め） |